

FLUX CORED WIRE SOLDER

STG

フラックス超低飛散タイプ

フラックス飛散を大幅に低減しました。
またフラックス残さが割れない
剥がれないという特長もあります。

Fine Solder



Product Features 製品特性

■ フラックス超低飛散を実現

特殊なフラックスの採用により、フラックス自体に粘性をもたせて、はんだ付け時のフラックス飛散を大幅に低減し、フラックス超低飛散を実現しました。

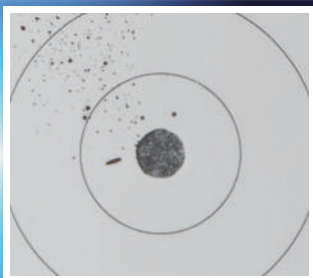
■ フラックス残さの割れ防止

常温はもちろん、高温下(85℃)や低温下(-15℃)においても、フラックス残さが割れにくい設計となっております。屈折部や可動部などのはんだ付けに最適です。

Ⅰ フラックス飛散率

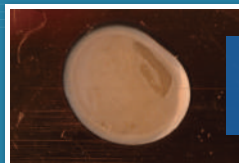


STG 1.76%



● 他社相当品 ● 14.94%

Ⅱ フラックスピンアタック試験



試験前

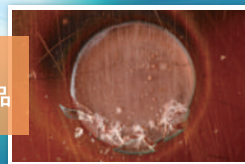


試験後

Ⅲ フラックスのひび割れ、飛び散りなし



試験前



試験後

Ⅳ フラックスのひび割れが発生

弊社品名	JIS記号	合金組成	固相線温度	液相線温度	線径 (mm)
FLF01	A30C5	Sn96.5%-Ag3.0%-Cu0.5%	約217℃	約219℃	φ0.3・φ0.4・φ0.5 φ0.6・φ0.8・φ1.0 φ1.2・φ1.6・φ2.0
FLF07	C7A3	Sn99.0%-Ag0.3%-Cu0.7%	約217℃	約226℃	
FLF03	C7	Sn99.3%-Cu0.7%	約227℃	約227℃	

項目	STG	規格(参考)
		JIS Z 3283/AA級
合金組成	FLF01/FLF03/FLF07	—
フラックス含有量	3%	2.7%以上3.3%未満
ハライド含有量	0.01%	0.1%以下
水溶液比抵抗	1,200Ωm	1,000Ωm以上
絶縁抵抗試験(85℃ 85%RH 168hr)	2×10 ⁹ Ω以上	1×10 ⁹ Ω以上
マイグレーション試験(85℃ 85%RH 1,000hr)	異常なし	樹枝状生成物がない事
広がり率	70%	65%以上

